

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年7月25日(25.07.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/108791 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/312 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08G 73/04 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
H01L 21/768 (2006.01) *H01L 23/532* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/050686
- (22) 国際出願日: 2013年1月16日(16.01.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-007151 2012年1月17日(17.01.2012) JP
- (71) 出願人: 三井化学株式会社(MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小野 昇子(ONO, Shoko); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 茅場 靖剛(KAYABA, Yasuhisa); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 田中 博文(TANAKA, Hirofumi); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 高村 一夫(KOHMURA, Kazuo); 〒7400061 山

口県玖珂郡和木町和木6-1-2 三井化学株式会社内 Yamaguchi (JP). 鈴木 常司(SUZUKI, Tsuneji); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 三尾 茂(MIO, Shigeru); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 中島 淳, 外(NAKAJIMA, Jun et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 H K 新宿ビル7階 太陽国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

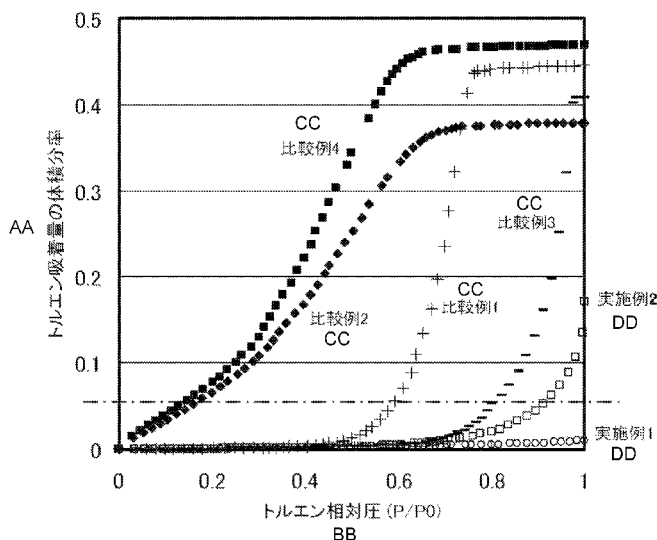
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR SEALING COMPOSITION, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING SAME, AND POLYMER AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 半導体用シール組成物、半導体装置及びその製造方法、並びに、ポリマー及びその製造方法

[図1]



AA Volume fraction of toluene adsorption amount
BB Toluene relative pressure
CC Comparative example
DD Example

(57) Abstract: In the present invention, a semiconductor sealing composition is provided, said semiconductor sealing composition: having at least two cationic functional groups including a tertiary nitrogen atom and/or a quaternary nitrogen atom; containing a polymer with a weight-average molecular weight of 2000 to 1000000, and a branching degree of at least 48%; and having a sodium and potassium content of not more than ten parts per billion by mass at the respective element standards.

(57) 要約: 本発明では、3級窒素原子及び4級窒素原子の少なくとも一方を含む2以上のカチオン性官能基を有し重量平均分子量が2000~1000000であり分岐度が48%以上であるポリマーを含有し、ナトリウムおよびカリウムの含有量がそれぞれ元素基準で10重量ppb以下である、半導体用シール組成物が提供される。



ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
- 補正された請求の範囲及び説明書 (条約第 19 条(1))